(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2011 年 9 月 15 日(15.09.2011)

PCT

(10) 国際公開番号
WO 2011/111166 A1

(51) 国際特許分類:
H01L 21/301 (2006.01) *H01L 21/52* (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2010/053879

(22) 国際出願日: 2010 年 3 月 9 日(09.03.2010)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 古河電気工業株式会社 (**FURUKAWA ELECTRIC CO., LTD.**) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目２番３号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および
(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 建部　一貴 (**TATEBE, Kazuki**) [JP/JP]; 〒1008322 東京都千代田区丸の内２丁目２番３号　古河電気工業株式会社内 Tokyo (JP).

(74) 代理人: 松下　亮 (**MATSUSHITA, Makoto**); 〒2220033 神奈川県横浜市港北区新横浜２－５－１９　アプリ新横浜ビル５階 Kanagawa (JP).

(81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KM, KN, KP, KR, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PE, PG, PH, PL, PT, RO, RS, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SM, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

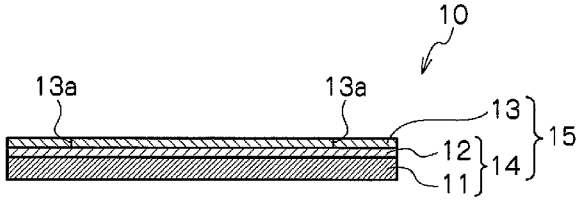
添付公開書類:
— 国際調査報告（条約第 21 条(3)）

WO 2011/111166 A1

(54) **Title**: FILM FOR WAFER PROCESSING, AND METHOD FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE USING FILM FOR WAFER PROCESSING

(54) 発明の名称 : ウエハ加工用フィルム及びウエハ加工用フィルムを用いて半導体装置を製造する方法

[図1]



(57) **Abstract**: Disclosed is a film for wafer processing which has a dicing/die bonding film composed of an adhesive layer and a sticky film, and is capable of sufficiently suppressing the formation of transfer marks on the adhesive layer when the film for wafer processing is wound into a roll. Specifically disclosed is a film for wafer processing which comprises a sticky film that is composed of a base film and a sticky layer provided on the base film, and an adhesive layer that is provided on the sticky layer. The sticky layer contains a radiation polymerizable compound and one photoinitiator at least in a portion corresponding to the ring frame, while containing a radiation polymerizable compound and another photoinitiator in a portion other than the portion in which the first-mentioned photoinitiator is contained. The wavelength of light to which the first-mentioned photoinitiator is reactive is different from the wavelength of light to which the another photoinitiator is reactive.

(57) 要約:　接着剤層及び粘着フィルムからなるダイシング・ダイボンディングフィルムを有するウエハ加工用フィルムをロール状に巻き取った場合に、接着剤層での転写痕の発生を十分に抑制することができるウエハ加工用フィルムを提供する。　本発明のウエハ加工用フィルムは、基材フィルム、及び前記基材フィルム上に設けられた粘着剤層からなる粘着フィルムと、前記粘着剤層上に設けられた接着剤層とを有し、前記粘着剤層は、少なくともリングフレームに対応する部分に、放射線重合性化合物と一の光開始剤とを含み、前記一の光開始剤を含む箇所以外の部分に、放射線重合性化合物と他の光開始剤とを含み、前記一の光開始剤が反応する光の波長は、前記他の光開始剤が反応する光の波長と異なる。